

## 結晶材料のダメージフリーを狙う加工と評価技術

半導体素材、電子デバイス素材などの結晶材料は、そのデバイス特性を最大限生かすために結晶欠陥の抑制が求められます。特に加工によって導入されてしまう結晶欠陥（加工ダメージ）は、デバイス製造工程において重要な管理項目となっています。一般的に加工ダメージ低減と加工効率向上は相反する要求にあり、高効率・ダメージフリー加工は加工における永遠のテーマであるといえます。また、結晶材料のダメージフリー加工を考えるには、結晶欠陥を正確に把握する評価技術も重要となります。本研究会では結晶材料のダメージフリーを狙った加工の最新状況と加工ダメージを正確に把握する評価手法について、4名の講師の方々に紹介していただきます。

※80回を記念して宮下政和先生の著書「研削盤の原理と設計」を配布予定

主催：公益社団法人 砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日時：2018年8月24日(金) 13:00～17:00

会場：明治大学駿河台校舎 リバティタワー9階 1096教室

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1丁目1

[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)



最寄り駅：JRお茶の水駅 徒歩3分、地下鉄丸ノ内線新御茶ノ水駅 徒歩5分、半蔵門線神保町駅徒歩5分

- |             |  |                               |
|-------------|--|-------------------------------|
| 13:00～13:15 | 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会の歩み                          | 安永 暢男 氏                       |
| 13:15～14:05 | <講演1> 「高脆性材料の超砥粒研削砥石による加工ダメージについて」             | 株式会社岡本工作機械製作所 伊東 利洋 氏         |
| 14:05～14:55 | <講演2> 「難加工硬質結晶の平坦化と勘どころ」                       | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 山本 悟 氏      |
| 14:55～15:10 | <休憩> 集合写真撮影を予定しております。                          |                               |
| 15:10～16:00 | <講演3> 「最先端レーザーラマン顕微鏡を用いた結晶品質イメージング評価」          | ナノフォトン株式会社 足立 真理子 氏           |
| 16:00～16:50 | <講演4> 「ワイドバンドギャップ半導体結晶の欠陥検出とその加工ダメージ検出への適用可能性」 | 一般財団法人ファインセラミックスセンター 石川 由加里 氏 |
| 16:50～17:00 | 閉会挨拶・事務連絡                                      | 委員長 池野 順一 氏                   |
| 17:15～19:15 | 技術交流会：リバティタワー17階 スカイラウンジ眺                      |                               |

参加費(技術交流会含)：次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会員：無料，非会員：15,000円(1社当り2名まで参加可)  
超砥粒ホイール研究専門委員会員及び同伴者2名まで：無料，追加者1名につき：15,000円

申込締切日：2018年8月16日(木) (注) 申込者で当日不参加の場合は参加費を請求させていただきます。

問合せ/申込先：

- ◆当専門委員会員，砥粒加工学会員，非会員⇒次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会事務局 田附 宙美 宛  
FAX：048-829-7046，E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp
- ◆超砥粒ホイール研究専門委員会員⇒明治大学理工学部 澤野 宏 宛  
TEL：044-934-7364，E-mail：[sawano@meiji.ac.jp](mailto:sawano@meiji.ac.jp)